



### 主要特点

内部集成 2: 4 译码器

通道数目: 4

通带频率: 9 - 10.1 GHz

10 - 11.1 GHz

11 - 12.1 GHz

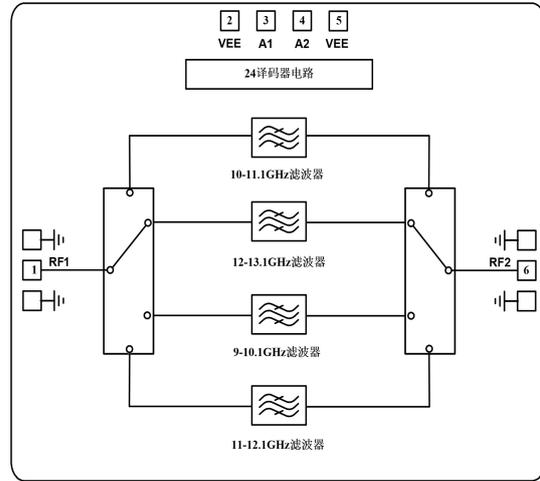
12 - 13.1 GHz

功耗: -5 V @ 6 mA

输入 P-1: 21 dBm

芯片尺寸: 2.5 × 3 × 0.1 mm<sup>3</sup>

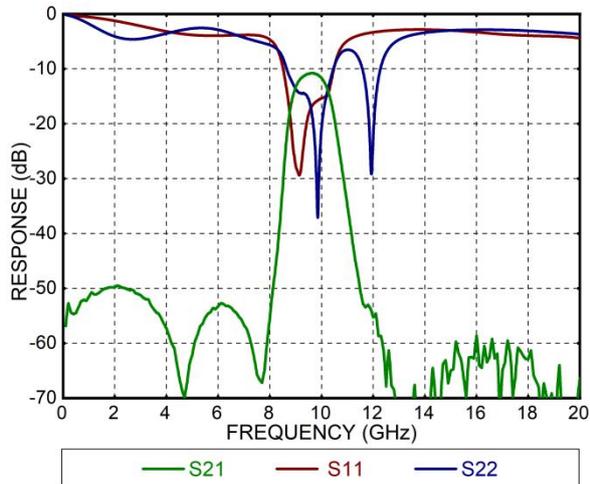
### 功能框图



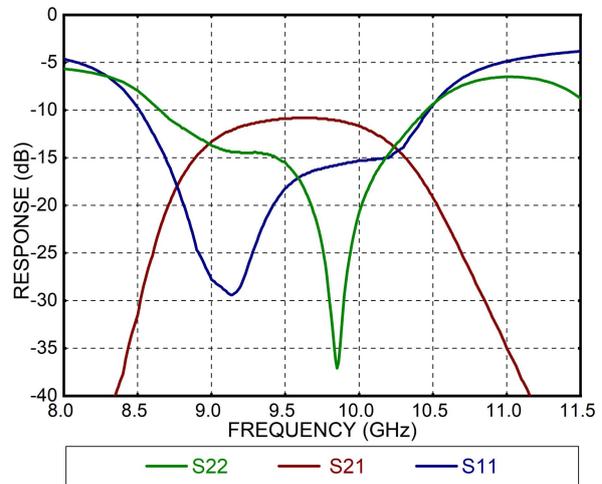
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $VEE = -5\text{V}$ )

参数	9-10.1GHz	10-11.1GHz	11-12.1GHz	12-13.1GHz	单位
插入损耗	11	11.5	12	12	dB
带内平坦度	±1.2	±1	±1.5	±1.3	dB
回波损耗	15	12	12	11	dB
带外抑制	40 @ 8.3GHz 40 @ 11.2GHz	40 @ 9.32GHz 40 @ 12.25GHz	40 @ 10.32GHz 40 @ 13.2GHz	40 @ 11.25GHz 40 @ 14.22GHz	dB

9-10.1GHz反射系数

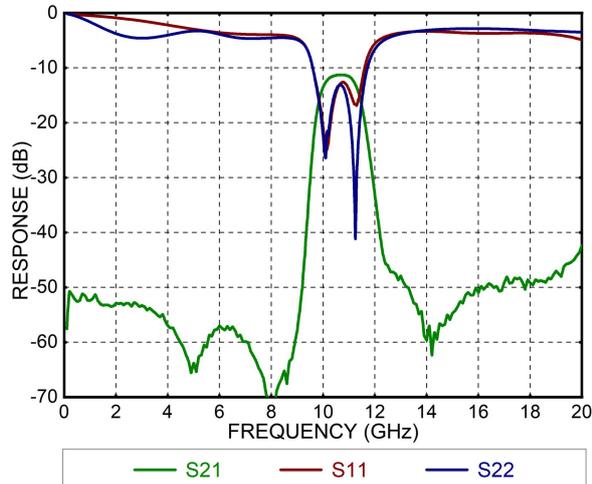


9-10.1GHz反射系数

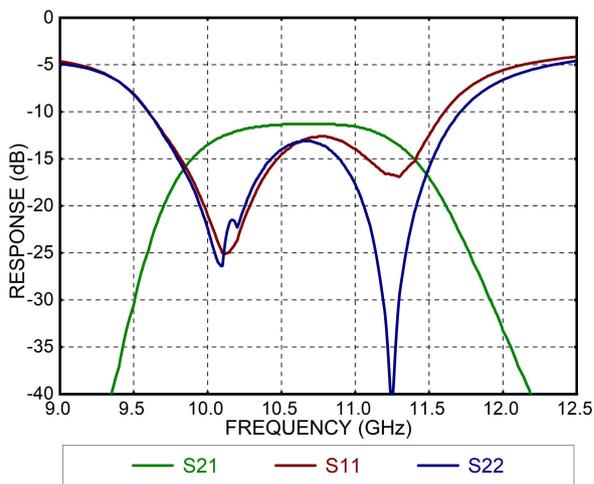




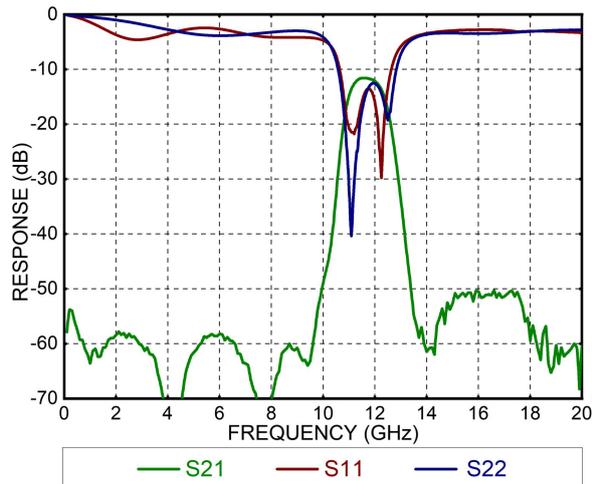
10-11.1GHz反射系数



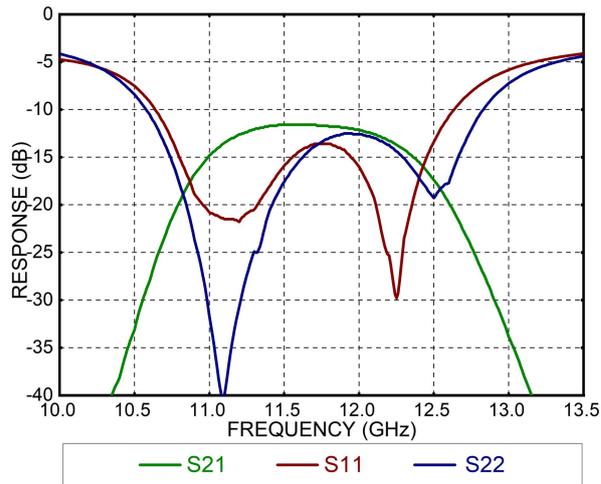
10-11.1GHz反射系数



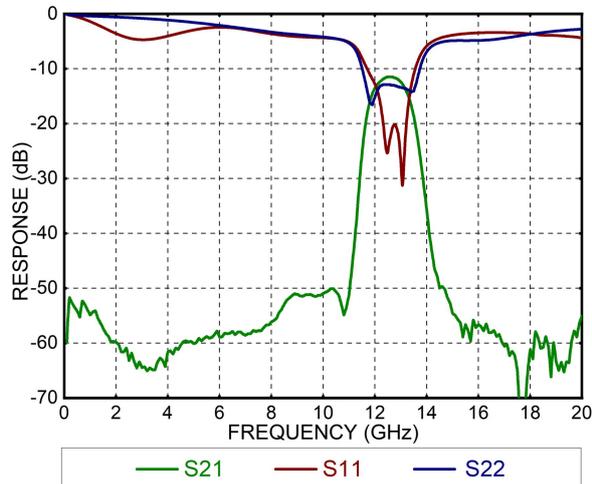
11-12.1GHz反射系数



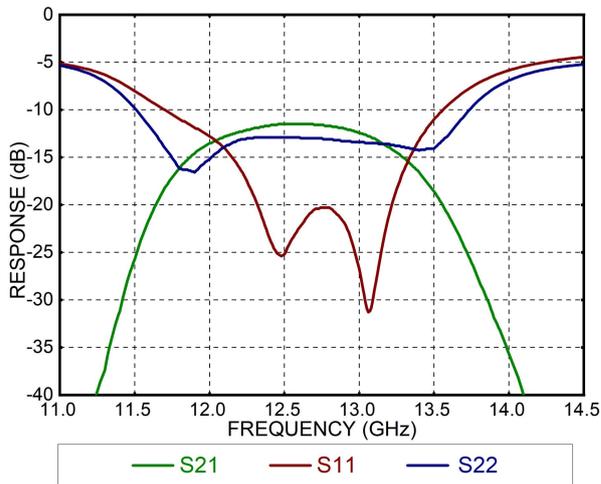
11-12.1GHz反射系数



12-13.1GHz反射系数



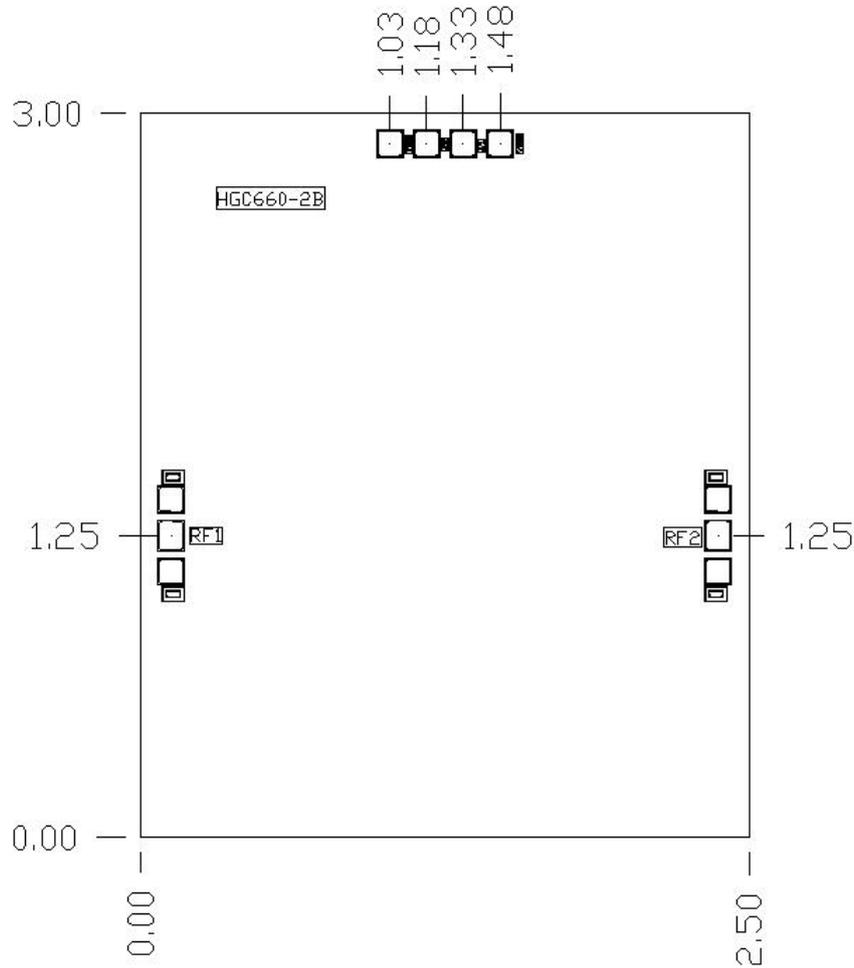
12-13.1GHz反射系数





## 物理参数

单位: mm



## 焊盘描述

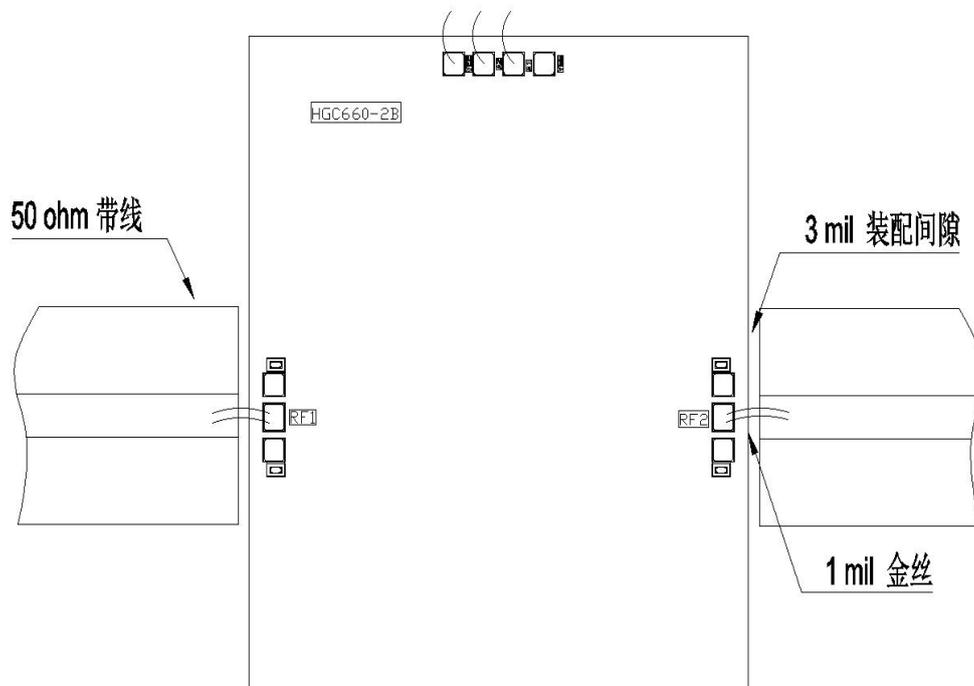
焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是 RF 信号输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
6	RF2	该焊盘是 RF 信号输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2、5	VEE	该焊盘是驱动电路电源端口, 使用时任选一端接-5V 电压
3、4	A1、A2	该系列焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



## 真值表

通道	A1	A2
9-10.1 GHz	0	0
10-11.1 GHz	1	0
11-12.1 GHz	0	1
12-13.1 GHz	1	1
“0”电平范围: 0~0.8 V, “1”电平范围: 2.3~5 V		

## 推荐装配图



## 注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100  $\mu\text{m}$
3. 典型键合焊盘尺寸为  $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN; 厚度:  $0.6 \mu\text{m}$

## 极限参数

1. 电源电压: -6 V
2. 射频输入功率: +27 dBm
3. 储存温度:  $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 工作温度:  $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$